

Lösungen für anspruchsvolle Elektronikfertigung

Thermal Management · Kleben · Dosieren · Vergießen

**BODO MÖLLER
CHEMIE**

TechDialog 2026 Von der Materialauswahl über die Applikation bis zur prozesssicheren Verarbeitung: Der TechDialog verbindet technisches Know-how mit konkreten Anwendungen und realen Herausforderungen aus der Praxis. Interaktive Workshops, Praxisbeispiele und der direkte Austausch mit unseren Branchenexperten machen die Seminarinhalte unmittelbar anwendbar.

Themen-Highlights

- 01 | CHEMIE ALS BASIS FÜR TECHNISCHE ANWENDUNGEN**
Materialien und ihre Eigenschaften gezielt auswählen
- 02 | THERMAL INTERFACE MATERIALS**
Wärmeleitpads und TIM-Folien prozesssicher und effizient verarbeiten
Automatisierte Applikation von Wärmeleitpads und TIM-Folien
- 03 | INNOVATIVE MATERIALIEN FÜR DIE ZUKUNFT**
Lösungen für Elektronik, Automotive und neue Wachstumsmärkte
- 04 | INTERAKTIVE WORKSHOP SESSIONS**
Lösungen für Leiterplatten und elektronische Baugruppen
Ohne Gehäuse vergießen – effizient und kostensparend
Präzise dosieren – automatisiert applizieren

1. Dezember 2026
NH Collection Heidelberg

Frühbucherpreis 325 €
pro Person zzgl. MwSt.
gültig für Anmeldungen bis 23. Oktober 2026

Seminargebühren 375 €
pro Person zzgl. MwSt.
Anmeldeschluss 20. November 2026

Weitere Informationen unter
www.bm-chemie.com/techdialog

Expertise und Know-how
aus erster Hand –
**melden Sie sich jetzt
an und sichern sich den
Frühbucherpreis!**